公司代码：688262　　公司简称：国芯科技

苏州国芯科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	国芯科技	688262	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	龚小刚	
电话	0512-68075528	
办公地址	苏州市高新区冯湖路99号狮山总部经济中心1号楼	
电子信箱	IR@china-core.com	

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,313,985,930.54	3,200,422,926.79	3.55
归属于上市公司股东的净资产	2,102,888,794.46	2,194,800,037.17	-4.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	170,579,919.13	261,397,564.69	-34.74
利润总额	-128,004,465.18	-117,836,109.09	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-86,411,242.58	-82,559,943.63	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,207,839.70	-96,101,053.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额	52,535,660.43	-19,742,914.59	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.02	-3.48	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.25	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.25	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	89.90	55.14	增加34.76个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				26,589			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0			
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)				0			
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宁波眼越创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	6.59	22,149,387	0	0	无	0
郑茫	境内自然人	5.51	18,527,812	18,527,812	18,527,812	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	3.87	13,004,645	0	0	无	0
肖佐楠	境内自然人	3.86	12,969,493	12,969,493	12,969,493	无	0
苏州国芯联创投资管理有限公司	境内非国有法人	3.86	12,961,160	12,961,160	12,961,160	无	0
西藏津盛委达创业投资有限公司	境内非国有法人	2.53	8,500,000	0	0	无	0
孙力生	境内自然人	2.22	7,457,894	0	0	无	0
宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	2.07	6,950,802	6,950,802	6,950,802	无	0
苏州国芯科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.01	6,761,090	0	0	无	0
宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.88	6,302,552	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，郑茫、肖佐楠、苏州国芯联创投资管理有限公司、宁波梅山保税港区旭盛科创投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系。宁波眼越创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波嘉信佳禾创业投资合伙企业(有限合伙)、孙力生为一致行动人关系；未知上述其他股东之间存在一致行动人关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

苏州国芯科技股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告

为践行以“投资者为本”的发展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，基于对公司未来增长潜力与内在价值所抱持的信心，苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“国芯科技”)于2025年4月29日披露了《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》(以下简称“方案”)。2025年上半年，公司依据该方案积极推进各项举措的落实，并严谨评估了方案的实施效果，公司于2025年8月25日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》，现将半年度工作成果报告如下：

一、重点推进自主芯片业务的发展，高强度开展新产品新技术研发工作

(一)重点发展汽车电子、信创和信息安全与端侧/边缘侧AI芯片等自主芯片业务

公司的自主芯片及模组产品以汽车电子、信创和信息安全、AI MCU芯片类为主，聚焦于汽车电子和“云-边-端”应用；同时，公司基于NPU技术，在已开发的AI MCU芯片的基础上，持续拓展AI MCU的应用场景，推进了AI MCU业务的蓬勃发展。

在汽车电子领域，在实现汽车域控制芯片、辅助驾驶处理芯片、主动降噪专用DSP芯片、动力总成控制芯片、新能源电池管理芯片、线控底盘芯片、车身和网关控制芯片、车联网安全芯片、仪表及小节点控制芯片、安全气囊芯片、数模混合信号类芯片和智能传感芯片等12条产品线系列化布局的基础上，公司坚持“顶天立地”、“铺天盖地”战略与“MCU+”策略不动摇，继续深耕深挖技术、加高加固护城河、拓宽拓广项目资源。公司重点发展的系列化汽车电子芯片产品逐步规模化上车应用，特别是安全气囊芯片、车身与网关芯片、车联网安全芯片、域控芯片、DSP芯片、动力总成芯片、新能源电池管理芯片、线控底盘芯片等产品线已实现规模化量产供货，在国产汽车电子芯片领域打开良好局面，特别是在比亚迪、奇瑞等大客户中取得较为重要的进展。同时，围绕小节点领域的方向盘离手检测、主动安全带、车用小执行器、传感器等领域，公司也积极开展应用探索并取得积极进展。在公司研发、技术支持、生产、质量、市场等多方面的积极奋进和创新下，公司汽车芯片业务稳步迈向新的里程碑，2025年上半年公司实现汽车电子芯片业务收入4,915.36万元，同比增长63.81%。

截至2025年6月30日，公司汽车电子芯片已累计出货超过170颗。目前，公司汽车电子芯片已陆续进入比亚迪、奇瑞、吉利、上汽、上汽通用、上汽通用五菱、长安、长城、一汽、东风、北汽、小鹏、理想、赛力斯、广汽等众多汽车整机厂商，实现批量应用。公司与埃泰克、经纬恒润、科世达(上海)、弗迪科技、弗迪动力、弗迪电池、长江汽车电子、欧菲智能、易鼎丰、英创汇智、安波福、松原安全、法雷奥等国际国内Tier1模组厂商保持紧密合作，同时与潍柴动力、奥易克斯、武汉菱电、常州易控、凯晟动力等多家发动机及模组厂商保持业务协同创新与合作。公司与经纬恒润、东软睿驰、普华软件等携手正式推出完整的Classic Platform (CP) AUTOSAR解决方案，加速助推“中国芯+中国软件”车用底层解决方案应用落地，获得了市场的认可和良好的业界口碑。

在信创和信息安全领域，2025年上半年，公司在高性能芯片及模组、量子/抗量子芯片及模组等方向上持续发力，不断攀上新台阶。公司一方面继续聚焦“云-边-端”系列化信息安全芯片及模组，另一方面积极开展量子技术合作，将信创和信息安全芯片与量子技术进行结合，实现信创和信息安全芯片迭代升级。除此之外，公司高可靠RAID存储控制芯片及模组已小批量供货，可实现同类产品的国产替代。

AI MCU领域，国芯科技基于推出的端侧AI芯片，与合伙伙伴联合开发出了丰富的产品与智慧应用方案。随着人工智能从“云”走向“端”，端侧AI迅速成为驱动智能设备变革的关键力量。公司利用自身在嵌入式芯片行业所积累的精深经验，在端侧AI这一人工智能的新战场上快步前进。2025年上半年，公司与生态链上各合作伙伴联合推出了包括智能家电、智慧看护、安全检测、电机等广泛领域的端侧AI应用方案并实现出货，涵盖安全防护、智能家居、工业控制、电力等多元化场景。

(二)高强度开展新产品新技术研发工作，AI技术与量子技术快速落地

公司作为国内嵌入式CPU领域的先行者和领跑者，2025年上半年继续发展边缘/端侧AI技术，并根据应用需求大胆创新，特别是在交叉领域的集成创新上，将研究成果应用到现有的汽车电子和工业控制芯片产品以及信创和信息安全芯片产品，持续投入AI神经网络处理器NPU技术的研发，用RISC-V CPU + AI NPU的技术创新坚定拥抱席卷世界的智能化浪潮；另一方面公司将抓住量子安全技术发展带来的难得历史机遇，积极发展量子安全技术，积极布局和研发抗量子密码算法、芯片和模组产品，持续推出具有国际先进水平的系列化量子安全和抗量子密码芯片与模组，努力成为国际量子安全芯片的先进供应商，为我国量子安全芯片技术在国际上占据更重要的地位作出贡献。

(1)基于RISC-V指令架构发展系列化高性能CPU内核

在嵌入式CPU领域，公司继续基于RISC-V指令架构投入研发，面向汽车电子和工业控制的实时应用，公司成功研发了CRV0、CRV4/CRV4E/CRV4H/CRV4L、CRV5、CRV7系列RISC-V CPU IP核，并且都有国产化软件开发工具链支持。其中：CRV4E在CRV4的基础上针对电机控制应用扩展了DSP指令；CRV4H是符合功能安全要求的处理器。另外，公司还基于RISC-V指令架构开展神经网络扩展指令集架构研究，在RISC-V处理器上运行扩展自定义指令，形成神经网络处理器专用指令集，能够支持神经网络算法的加速处理，并用于CRV4AI和CRV7AI处理器的实现。公司正在优化设计适用于汽车电子高端域控支持虚拟化应用的CRV6 CPU IP核。与赛昉科技合作，完成CRV9 CPU IP核引进合作以及与北京开芯院合作，完成CRV9H IP核引进合作，可满足高性能计算的应用需要。

在NPU领域，公司面向端/边缘侧应用和面向AIPC应用开展NPU技术研发，形成CNN20、CNN100、CNN200和CNN300系列化NPU IP核。

CNN20、CNN100和CNN200是面向端/边缘侧MCU或SoC应用的NPU IP核，CNN20和CNN100已完成设计并可以对外授权，CNN200正在研发中；CNN20/CNN100/CNN200采用GCU+NN网络架构设计，配套的NPU工具链涵盖了从模型格式转换、预处理、量化、编译、仿真等不同功能的工具，为NPU的推理实施、应用落地提供软件生态支撑。CNN20/CNN100单核算力可达1 Tops@INT8，适用于低功耗要求的AI MCU芯片；CNN200单核算力可达10 Tops@INT8，适用于各种边缘计算AI SoC芯片，可广泛应用于包括机器狗等众多AI应用场景中。

CNN300是面向AI PC应用的NPU IP核，正在研发中，CNN300以标量运算单元和矢量运算矩阵相结合，利用专用重构化可编程技术，形成通用可编程NPU(GPNPU)形式的人工智能加速体，单核性能可达8 TOPS，CNN300具有多核一致性接口MLS，支持多个CNN300 IP核之间扩展实现更高算力，保障单任务多核情况下数据流的同步和统一，如利用四核堆叠实现32 TOPS算力；MLS接口也支持多颗集成CNN300 IP核的SoC芯片之间进行数据一致性同步，使得SoC芯片能够利用chiplet机制实现多核多芯片算力堆叠效果。CNN300将支持INT8/ FP8/FP16等常规AI应用所需要的数据类型，支持传统的CNN、RNN应用，也能支持最新流行的LLM(大语言模型)应用，可以配合应用进行Deepseek、Qwen、LLaMa等常用大模型卸载，满足常规诸如语音图像视频识别应用场景，也能够支持AI PC应用的高品质语音视频显示、生成式人工智能(如文生文、文生图等)、Moe(多模态交互)、知识库管理等应用；相比于传统ASIC形式NPU加速器，CNN300的GPNPU形态具有灵活可重构和高性能高带宽低功耗特点，可以广泛、快速适用于未来Deepseek之外的新大语言模型应用场景；CNN300将具有完整的自主可控的生态工具，包含计算图编程接口、计算库API支持、高效优化代码的编译器支持以及硬件模拟调试。

(2)以先进架构和先进工艺构建汽车电子芯片核心竞争力

随着新能源汽车智能化进程加快，传统12V低压系统已难以满足新一代智能功能的功率需求。48V系统以其更高的功率承载、更优的能效表现和更强的功能安全保障，成为汽车电气架构升级的关键路径。公司积极应对这一发展趋势，尝试构建48V混合信号芯片设计平台，CCL1800B是面向48V架构的首款安全气囊点火芯片，实现业界首发，作为48V安全气囊点火芯片填补了这一领域的空白，实现了新能源汽车安全气囊点火应用电子电气系统架构领域的创新与突破。以该芯片为基础，公司搭建48V混合信号芯片设计平台，平台化布局初步成型并支撑后续多应用领域扩展。

新能源汽车智能化和电气化发展倒逼芯片结构向域集成化升级达到成本和效能优化，从而推动集成高算力、传感器信号采集处理、通信技术、低功耗和高可靠性的芯片发展。结合重大客户产品应用需求，公司启动了CCFC3009PT芯片研发，这是面向汽车辅助驾驶和跨域融合领域应用而设计开发的高端MCU芯片，芯片基于22nm RRAM工艺，采用高性能RISC-V架构的多核CRV6 CPU(6个主核+6个锁步核，并且根据应用需要灵活再配置主核+锁步核数量)，运行频率达到500MHz，预计算力可达到10000DMIPS以上，芯片内置NPU，支持未来AI功能拓展和可预测性维护，性能媲美英飞凌TC49X和瑞萨U2B系列芯片，且更具性价比优势，具备国际先进水平。

(3)以RISC-V CPU +AI NPU发展人工智能芯片产品

公司CCR4001S芯片采用RISC-V内核CRV4H设计，芯片内置NPU，支持流行的深度学习框架(如TensorFlow/TensorFlow Lite/PyTorch/Caffe等)，为更广泛的应用提供AI计算能力。CCR4001S能够高效运行MobileNet/ResNet/ EfficientNet/Yolo等深度学习算法，使设备能够实时完成物体识别、目标检测、图像分类等复杂任务。芯片设计还考虑到了低功耗和高性能之间的平衡，确保了在各种应用场景中都能实现卓越的表现。CCR4001S应用涵盖了生活的多个方面，从智能家居的智能控制系统，到智慧健康的人性化看护，再到新能源领域的安全检测与预测性维护等。目前，CCR4001S在智能家电、智能看护、电弧检测等应用领域中已推出了产品化方案，部分客户产品已实现量产或正在测试中。

(4)云安全芯片实现迭代升级

公司基于RISC-V架构多核CPU成功研发了超高性能云安全芯片CCP917T，CCP917T超高性能云安全芯片基于国芯科技自主RISC-V架构的CRV7多核处理器设计，CPU主频可达1.4GHz，集成了神经网络处理单元(NPU)，可以适应更多高性能计算、高速数据处理和人工智能推理等复杂应用场景。该芯片内嵌高性能安全算法引擎(SEC)，支持国密标准算法(包括SM1\SM2\SM3\SM4\SM7\SM9等)和国际通用算法(包括RSA\ECC\AES\DES\SHA\RC4\ZUC等)，支持芯片内部高性能随机数生成以及外接高性能随机数芯片。该芯片具有多种安全防护机制，支持安全启动，支持片外数据安全存储，其中SM2签名效率达到100万次/s，对称算法性能达到80Gbps。该芯片支持一组PCIE4.0x16和一组PCIE4.0x4高性能接口，支持SR-IOV硬件虚拟化技术，最多可支持256路虚拟机，可并发使用CCP917T的算法资源，并支持芯片级联扩展以提升性能。该芯片还带有DDR4高速存储接口，可以运行复杂操作系统以适应各种APP应用场景，方便客户进行板卡二次开发。此外，该芯片还带有千兆以太网接口、USB3.0接口、EMMC存储接口以及必要的低速外设，用以进行复杂应用。CCP917T具备了超高性能、高安全性、高可靠性以及高扩展性，参数指标优异，可以适用于各种对安全、性能和稳定性要求高的场合。超高性能云安全芯片CCP917T超高的算法性能和接口带宽，为云安全应用场景下的数据处理提供高带宽、低延迟、快响应支撑，可以广泛应用于信息安全各个领域：①需处理大规模加密数据流、虚拟化资源动态分配，以及存储加密服务的云计算；②超低时延、海量连接场景需高效密码运算的5G网络；③需处理高并发交易、实时加解密及身份验证的金融系统；④需满足国家三级及以上等保要求，实现敏感数据全流程保护的政务系统；⑤需海量数据安全加密、安全访问的数据中心；⑥高性能可信安全服务器、AI推理机、VPN网关、防火墙等高性能计算和网络安全设备等，该款芯片达到行业先进水平。

(5)抗量子密码算法、芯片和板卡持续创新

针对NIST公布的基于格原理、哈希原理和编码原理三种类型的五个抗量子密码算法，公司已开展从抗量子密码算法理论研究、算法硬件架构设计、算法软硬件实现，算法侧信道安全等多层次和多维度的深入研究。目前已完成了NIST FIPS 203(ML-KEM)、FIPS 204(ML-DSA)、FIPS 205(SLH-DSA)三个算法模块的硬件设计，其中ML-KEM和ML-DSA是基于格原理的抗量子密码算法，SLH-DSA是基于哈希原理的抗量子密码算法。同时还提交了五个抗量子密码算法硬件设计及侧信道防护相关的专利申请。ML-KEM/ML-DSA/ SLH-DSA三个抗量子密码算法IP已成功应用在公司的抗量子密码产品中。正在进行NIST FIPS 206(FN-DSA)的算法硬件设计以及NIST HQC算法的理论研究及算法硬件架构设计，其中FN-DSA是基于格原理的抗量子密码算法，HQC是基于编码原理的抗量子密码算法。后续还将基于现有的格原理的抗量子密码算法引擎添加更多的算子指令，从而能支持更多的基于格原理的抗量子密码算法，同时还将针对多变量原理和同源原理进行算法理论的研究和软硬件实现等工作。

面对量子计算的威胁，2025年上半年，国芯科技联合参股公司郑州信大壹密科技有限公司研发了抗量子密码芯片AHC001，并有自主研制的抗量子密码卡CCUPHPQ01内测成功，为国芯科技打造系列抗量子密码产品肇造了良好开端。AHC001是基于国产28nm工艺制程，并采用国芯科技自主可控CPU内核设计的一款可重构低功耗抗量子密码算法芯片，典型工作功耗和静态低功耗可分别低至350mW和0.13mW左右。芯片内集成了抗量子密码算法引擎、ECC引擎以及对称密码处理器。抗量子密码算法引擎采用可重构电路技术实现，具备低功耗、算法可重构、高安全性以及高扩展性特点，可用于多种应用领域产品的高安全防护，适用于今后对安全要求较高的各种端和边缘侧设备场合。公司已完成抗量子POS芯片的开发，目前该芯片产品已在流片生产中。

公司在2025年6月成功研制了抗量子密码卡CCUPHPQ01，该抗量子密码卡是一款基于抗量子密码算法与经典国密算法相结合，以公司自主设计研发的CCP1080T安全芯片为主控芯片，外加一颗国产FPGA芯片而设计完成的高性能密码安全产品。该产品遵循国家密码管理局关于密码模块、PCIe密码卡等相关技术规范，支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密算法，同时支持主流的抗量子密码算法，如Kyber512/Kyber768/Kyber1024加密算法、Dilithium2/Dilithium3/Dilithium5数字签名算法等，其中：抗量子密码算法Kyber512密钥生成速度达到2700次/s，加密速度达到2300次/s，解密速度可达到1800次/s；Dilithium2算法密钥生成速度达到860次/s，签名速度达到190次/s，验签速度达到600次/s。该产品支持抗量子密码算法更新，能够很好地跟进抗量子密码算法的迭代及标准化推进过程。该新产品的随机源采用CQWNG10量子随机数芯片，该随机数芯片的随机性源自于量子物理原理，并可采用物理熵理论严格证明其随机性，具有更高的安全性和更快的随机数生成速度。该抗量子密码卡新产品可以同时支持抗量子密码算法和传统密码算法应用，采用抗量子密码卡的安全产品或设备可以通过抗量子密码算法和传统密码算法共存方式，逐步进行抗量子密码算法应用迁移，在保障原有业务不受影响的情况下开展抗量子密码算法在新业务中应用，既满足现有业务系统密码应用，又能有效抵御量子计算攻击，进而增强了安全产品或设备抗量子计算攻击的能力。该抗量子密码卡新产品能够为各类安全平台提供多线程、多进程处理的高速密码运算服务，满足其对数字签名/验证、非对称/对称加解密、数据完整性校验、真随机数生成、密钥生成和管理等功能的要求，保证敏感数据的安全性、真实性、完整性和抗抵赖性。该抗量子密码卡产品可以适配龙芯、飞腾、海光等主流平台，支持UOS、麒麟、Linux等主流操作系统，可广泛应用于金融、通信、电力、物联网等领域以及签名/验证服务器、安全网关/防火墙等有高安全要求的信息安全设备中。

公司新推出的抗量子产品可以同时支持抗量子密码算法和传统密码算法应用，安全产品或设备可通过抗量子密码算法和传统密码算法共存方式，逐步进行抗量子密码算法应用迁移，成为保障信息安全领域量子密码技术平稳迁移的坚实桥梁。

(6)安全系统和模组产品稳步推进

在系统和模组方面，进行的研发主要有：①基于CCP1080T的系统应用开发，包括Linux系统及欧拉系统移植及驱动开发；②启动并完成CCP1080T二级密码卡的硬件设计，后续进行软件开发、生产、测试和型号申请等工作；③结合硅臻公司和问天量子公司的量子随机源设计开发了系列量子安全模组产品，包括量子安全U盾、量子密码卡(包括标准国密二级PCIE密码卡、标准国密三级PCIE密码卡、MINI-PCIE密码卡、M.2密码卡等多种形态)，结合高性能量子随机数的高安全性，涵盖安全模组多样性需求。

二、注重知识产权保护，转化成果显著

2025年，公司愈发重视知识产权工作，推出奖励措施鼓励员工积极参与技术研发与成果转化。2025年上半年，国芯科技申请专利23项(其中发明专利23项)，申请数同比增长283.33%；申请软件著作权21项，申请书同比增长90.91%；申请集成电路布图4项，商用密码证书2项。授权专利18项(其中发明专利18项)，软件著作权21项，商用密码证书2项。截至2025年6月30日，累计有效专利173项(其中发明专利164项、实用新型6项、外观专利3项)、累计有效软件著作权229项、有效集成电路布图44项、商用密码证书41项。专利数相比2024年12月31日上升11.61%，软件著作权数上升10.10%，商用密码证书上升5.13%。

作为一家关注自主可控的CPU设计公司，国芯科技始终将技术创新视为公司发展的生命线与核心驱动力，并将知识产权视为保护创新的关键基座。公司将持续推动把员工的宝贵创新成果及时转化为知识产权，从而为公司的长远发展注入源源不断的动力。

三、全力以赴推进市场拓展和深化，持续夯实品牌根基

在汽车电子芯片领域，公司继续坚持“顶天立地”和“铺天盖地”的发展战略，推行“MCU+”策略，汽车电子芯片业务的市场拓展取得明显成效；信创和信息安全紧密贴合市场需求，积极响应大客户的变化，并努力开拓具有优势的新细分市场，市场拓展取得积极进展，品牌形象继续提升。

(一)以市场为龙头，全力推进实现产品更多应用和量产

(1)汽车电子芯片的市场开拓、装车量产取得显著进展

公司中高端的域控制芯片包括CCFC3007PT、CCFC3007BC等。CCFC3007PT已经在多家头部主机厂的位置域控制器(ZCU)和车身域控制器应用实现装车，CCFC3007BC系列已获得多家头部汽车零部件厂商客户定点开发，主要用于客户车身域控制器的低成本方案。在已量产芯片CCFC3007XX/CCFC3008XX系列基础上，公司适时推出了更高性能的MCU CCFC3310PT/CCFC3011PT/CCFC3012PT芯片系列，实现对域控制芯片领域的低、中、高全面覆盖。

车载声学DSP芯片系列CCD5001/CCD4001/CCD3001采用12nm先进工艺技术设计和生产，已有多家客户在实际开发应用中，产品可广泛用于汽车音频放大器、音响主机、主动降噪ANC/RNC、后座娱乐和数字驾驶舱等，公司的DSP芯片在2025年3月启动量产。

动力总成芯片CCFC2006PT已在重型发动机中获得实际应用；CCFC2007PT采用国产40nm eFlash工艺，已量产；CCFC2017BC已在国内头部主机厂乘用车发动机ECU获得装车应用；高端动力总成控制芯片产品CCFC3008PT芯片已在VCU领域批量出货。高端动力总成控制芯片产品CCFC3007PT在国内头部企业发动机ECU进行台架实验，并获得多家发动机和电机控制器客户的定点开发，是公司基于客户更高算力、更高信息安全等级和更高功能安全等级应用需求而开发的全新多核架构芯片。

新一代高性能新能源电池管理控制芯片CCFC3008PT已送样给新能源BMS相关模组厂商进行评估和开发测试；CCFC3008PC可用于动力电池BMS的低成本方案，已有多家主机厂客户及动力电池头部厂商项目定点开发。

在底盘应用领域，CCFC2012BC/CCFC2011BC已经在客户的底盘类产品如换挡器、ABS、EPBI等应用实现了批量供货和产品订单；CCFC2016BC/CCFC2017BC用于空气悬挂系统和CDC悬挂转向控制，如空气弹簧等，已经进入实车测试阶段；多通道的传感器PSI5接口协议收发器芯片CIP4100B已获得多家客户定点开发并装车试用；CCFC3008PC已经获得多家头部底盘线控转向控制器厂家定点开发，CCFC3007PT+CCL2200B和CCFC3010PT+CCL2200B已经获得多家头部底盘线控制动控制器厂家定点开发。

CCM4202S车规安全芯片已在国内头部主机厂智能座舱应用中实现批量供货。车规级安全MCU芯片继续放量出货，上半年累计出货超过去年全年出货量。

汽车门区驱动芯片CCL1100B主要面向车门、窗、后视镜的执行器等应用，已给重点客户送样；底盘电磁阀控制驱动芯片CCL2200B，用于汽车电子稳定性控制器(ESC/ESP/OneBox)应用，已给重点客户送样；NFC射频收发芯片CN7160主要面向汽车PEPS(无钥匙进入)等应用。

安全气囊点火驱动芯片CCL1600B芯片已实现量产装车，并获得多个国际国内主流安全气囊Tier1厂商多项定点开发。公司的MCU芯片在安全气囊控制器产品已实现稳定批量应用，在安全气囊控制器单点装车应用中超过300万颗，已充分证明了其卓越的安全性和可靠性。广汽集团与国芯科技联合开发的气囊点火芯片正在推进上车应用。同时，公司与北京万得嘉瑞、浙江埃创、松原安全、安徽拙盾等积极推进安全气囊芯片的创新与应用。北京万得嘉瑞于2024年12月与国芯科技达成战略合作，积极在安全气囊控制器项目中选用国芯科技的“CCFC201XBC系列+CCL1600B系列”套片方案。2024年11月13日，国芯科技与松原安全正式签署战略合作框架协议，双方携手旨在打造国内最具竞争力的气囊点火方案，提升国产汽车安全系统的性能和可靠性，松原安全积极在安全气囊控制器项目上选用国芯科技的“CCFC201XBC系列+CCL1600B系列”的配套方案，目前已实现批量供货。2025年3月21日国芯科技-安徽拙盾安全气囊技术联合实验室揭牌，该实验室将促进芯片技术与安全气囊控制器技术的融合创新。

仪表及小节点控制领域，CCFC2011BC、CCFC2010BC主要用于驾驶信息显示系统(液晶仪表盘)，包括电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表的控制和汽车总线连接应用，已量产；CCM1002BC是面向汽车小节点应用的高性价比MCU，覆盖天窗、雨刮、灯控、UWB、遥控钥匙等汽车小节点应用，已经开始给客户送样并获得项目定点开发。

智能传感芯片CMA2100B，主要用于安全气囊ECU模组的周围传感器单元，已内测成功并给客户送样。

(2)信创和信息安全业务保持领先地位

信创和信息安全领域，公司在云-边-端业务、量子/抗量子芯片及模组、高性能云安全芯片及模组等方向上持续发力。

公司的云安全产品得益于行业政策驱动与产业对云安全保护等级提升的需求，公司云安全业务产品已规模化应用于信安世纪、格尔软件、国家电网、深信服、中安网脉、吉大正元、中星电子等合作伙伴的产品中，助力云安全厂商的业务升级。

公司在生物特征识别、金融安全细分市场继续领先，并有端安全新产品CCM3310S-LP无线充鉴权芯片已获得试用，多个项目正在推进中；持续开拓微型打印机主控芯片市场，CCM4201S、CCM4201S-L、CCM4208S等产品可用于标签打印机、票据打印机、面单打印机和工业打印机等应用中，已被行业知名企业采用。在高等级安全领域，公司推出了一系列可应用于高等级安全领域的安全芯片，该芯片用于人员身份认证、设备安全接入等场景，搭载了上述芯片的安全认证系统及前端安全设备已广泛应用于高等级安全领域。

量子/抗量子领域，公司多款量子安全芯片及模组产品已被中电信量子、问天量子等量子领域的头部企业采用并已实现销售，成功应用于电力等关键领域中。2025年5月，公司通过与信大壹密合作开发，推出了抗量子密码芯片AHC001，可用于多种应用领域产品的高安全防护，适用于今后对安全要求较高的各种端和边缘侧设备场合。2025年5月29日金融领域的权威国际组织PCI组织颁布了PCI7.0标准，正式将抗量子算法列入PCI要求，公司联合中云信安(深圳)科技有限公司针对该情况进一步完善设计了支持抗量子密码算法的CUni360SQ-ZX芯片，目前该芯片已流片，流片完成后将委托权威机构对该芯片进行基于PCI7.0标准的终端芯片安全评估。

RAID市场，一方面，公司自主研发的CCRD3304芯片已成功导入移动通信基站、信创服务器等多个项目中，上述项目均已开始小批量供货。另一方面，某头部视频监控设备厂商成功导入CCUSR6104 RAID卡，实现了小批量出货。除此之外，某国家重大需求项目已经选型公司CCUSR8116 RAID卡，开始小批量装机。

(二)积极传递产品价值与市场信息，打造良好的品牌形象

为持续传递公司的核心竞争力、投资价值和产品价值、市场信息，公司着力打造良好的品牌形象，积极向外界传递企业真实的声音。

2025年上半年，国芯科技及子公司先后参加了天津豪密高峰论坛、苏州第三届先进技术成果转化大会、中国国际新能源汽车技术、零部件及展览会、慕尼黑上海电子展、上海国际汽车工业展览会、第十二届汽车电子创新大会(AEIF)等行业内知名展会，更携生态链伙伴联合参加苏州STcon智慧技术及应用大会，并积极策划实施“走进主机厂”系列活动，先后走进奇瑞、一汽、赛力斯、理想等主机厂，与主机厂技术人员和工程师们进行深入交流探讨。2025上半年，公司召开了DSP量产发布仪式、举办“智驭未来‘芯’动之声”自主可控汽车电子芯片创新技术交流研讨会，并联合苏州市汽车电子及零部件产业商会开展“走进国芯”活动。

公司始终以技术产品为根基、以狠抓质量为保障，以市场为抓手，持续发力品牌建设，进一步提升品牌的影响力与口碑。公司也积极通过公众号等品牌传播渠道，以产品价值和市场信息传递为核心，加强品牌宣传，深化公司与公众的沟通，为品牌的长远发展添砖加瓦。

2025年上半年，公司凭借出色的创新与优秀的产品质量，荣获了中国汽车芯片联盟颁发的“2025年度创新力汽车芯片大奖”、中国集成电路设计创新联盟、中国汽车芯片产业创新战略联盟和上海市汽车工程学会颁发的“2025金芯奖·创新企业奖”、深圳市汽车电子行业协会颁发的“2024年度汽车电子科学技术奖”等奖项。荣誉是激励，激励我们继续奋发、干事成事，既能沉心钻研、也能耕耘收获。

四、精细化内部管理，提升经营效能和毛利率

2025年上半年，公司在复杂多变的市场环境中，高度重视内部管理优化与经营效能提升，持续推进公司综合竞争力的提升，公司综合毛利率达到36.82%，毛利率同比取得明显改善。

(一)全面加强财务管理和分析，切实执行预算管理制度

2025年上半年，现金流预算管理成为重中之重。公司切实执行现金流预算管理，全力推行资金计划与业务计划的穿透式管理模式。从预算编制阶段开始，精心规划资金流向，结合市场动态、业务拓展计划以及成本支出预期，确保预算编制的科学性与合理性，并根据实际情况，定期对预算进行调整。在执行监控环节，利用财务软件与数据分析工具，对资金的实际使用情况进行实时跟踪，一旦发现偏差，启动差异分析流程，并制定和执行相应的改善方案。通过闭环管控机制，公司对经营性现金流、自由现金流等关键指标进行实时监控与预警，公司的经营性现金流同比实现由负转正，出现明显改善。

(二)深化存货全过程管理，积极优化库存水平

2025年上半年，公司存货管理工作持续深化。在库存盘点核查方面，公司扩充了库房面积、优化了库存空间布局，提高了盘点效率。在盘盈盘亏分析方面，公司基于统计数据进行数据挖掘和分析，优化细化成本核算，确保各类存货成本的准确计量，为公司成本控制与定价策略提供可靠依据。

为优化库存管理，公司从销售端获取订单开始，便会结合库存情况、生产周期以及市场需求预测，对生产进行准确计划。对于长账龄库存商品，公司根据实际市场情况制定有针对性的销售策略，提高产品的销售速度，提升存货周转率。在存货价值管理方面，公司完善存货价值管理体系，严格按照会计准则进行会计核算，在存货跌价测试环节，采用科学合理的方法，结合市场价格波动、产品更新换代速度等因素，从严进行跌价测试，确保存货价值在财务报表中得到合理反映。

(三)加强催收联动，优化付款条件

2025年上半年，公司重点加强应收款回款并建立“事前评估、事中跟踪、事后催收”的全流程管理体系：事前，针对不同客户群体建立了完善的信用评级机制；事中，对每一笔订单的回款进度进行实时跟踪，若出现逾期情况，系统会及时预警，了解逾期原因并制定回款计划；事后，建立灵活且有力度的催收机制。公司还制定了新订单管控制度等系列措施。经过努力，公司应收账款周转率进一步提升，逾期账款占比进一步下降。

在采购付款方面，公司以“保障供应、控制成本、优化资金”为目标，实现了付款效率与资金效益的平衡。公司与核心战略供应商建立了更为紧密的合作关系，同时与多家银行建立合作关系，争取更优惠的票据贴现利率，降低融资成本。

(四)严格采购审批，严控采购成本

2025年上半年，公司积极推进降本增效策略，在各事业线、各部门推行实施招标采购、优化测试治具共享机制、严控非生产性采购支出、推行订单导向型生产计划以降低库存水平等有效措施，持续提升管理效率并降低运营成本。公司继续深化产业链管理，已建立起涵盖品质、交期、服务及价格等多维度的供应商评价体系并贯彻实施，指导供应商优选与产能分配，有效提升了公司产品品质、